

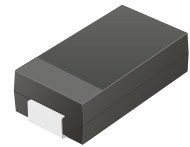
CDBA140-HF Thru. CDBA1100-HF

Reverse Voltage: 40 to 100 Volts

Forward Current: 1.0 Amp

RoHS Device

Halogen Free

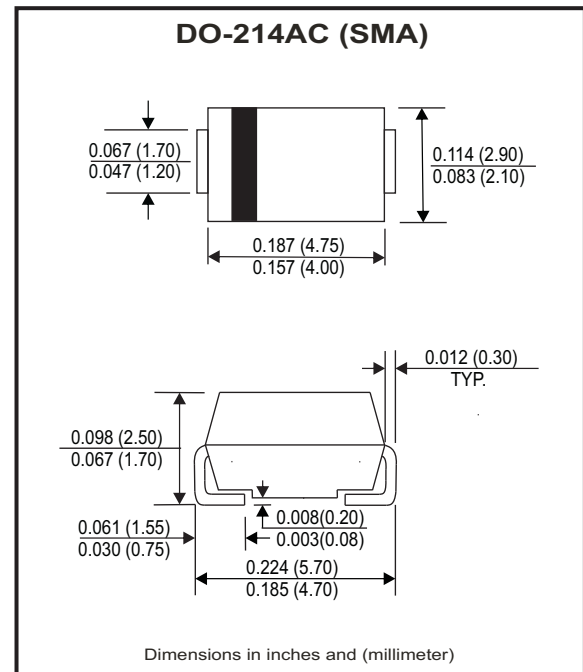


Features

- Low Profile surface mount applications in order to optimize board space.
- Low power loss, high efficiency.
- High current capability, low forward voltage drop.
- High surge capability.
- Guard ring for overvoltage protection.
- Ultra high-speed switching.
- Silicon epitaxial planar chip, metal silicon junction.

Mechanical data

- Epoxy: UL94-V0 rate flame retardant.
- Case: Molded plastic, DO-214AC / SMA
- Terminals: solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- weight: 0.055 grams



Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Ratings at $T_a=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted.
Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive loaded.
For capacitive load, derate current by 20% .

Parameter	Symbol	CDBA 140-HF	CDBA 160-HF	CDBA 1100-HF	Units
Max. Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	40	60	100	V
Max. DC blocking voltage	V_{DC}	40	60	100	V
Max. RMS voltage	V_{RMS}	28	42	70	V
Max. instantaneous forward voltage @1.0A, $T_A=25^{\circ}\text{C}$	V_F	0.50	0.70	0.81	V
Operating Temperature	T_J	-50 to +150			$^{\circ}\text{C}$

Parameter	Conditions	Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	Units
Forward rectified current	see Fig.1	I_o			1.0	A
Forward surge current	8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load (JEDEC method)	I_{FSM}			30	A
Reverse Current	$V_R = V_{RRM}$ $T_A=25^{\circ}\text{C}$	I_R			0.5	mA
	$V_R = V_{RRM}$ $T_A=100^{\circ}\text{C}$	I_R			20	mA
Thermal Resistance	Junction to ambient	$R_{\theta JA}$		88		$^{\circ}\text{C/W}$
Diode Junction capacitance	f=1MHz and applied 4V DC reverse Voltage	C_J		120		pF
Storage temperature		T_{STG}	-50		+175	$^{\circ}\text{C}$

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:B

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBA140-HF thru CDBA1100-HF)

Fig.1 - Typical Forward Current Derating Curve

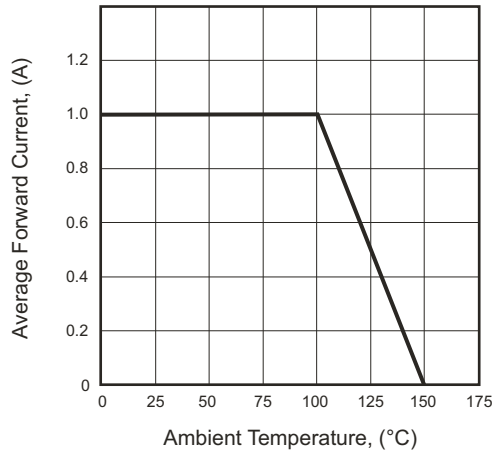


Fig.2 - Typical Forward Characteristics

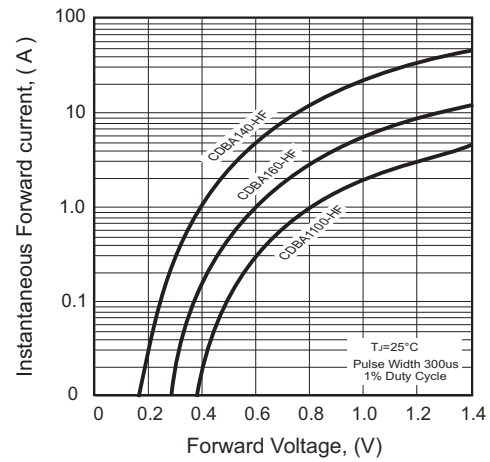


Fig.3 - Maximum Non-repetitive Forward Surge Current

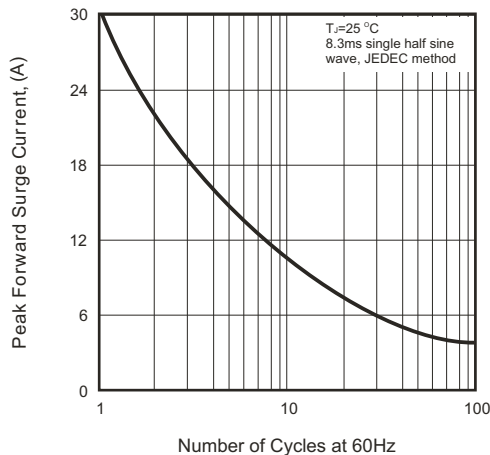


Fig.4 - Typical Junction Capacitance

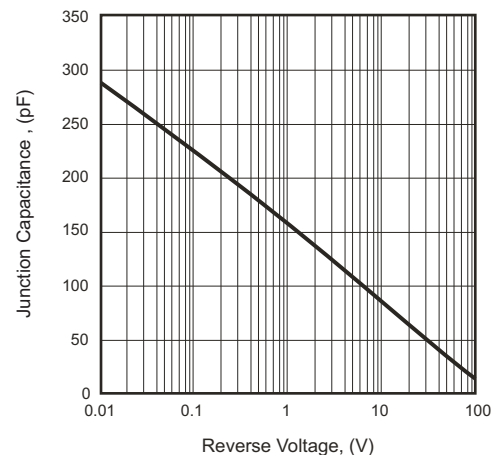
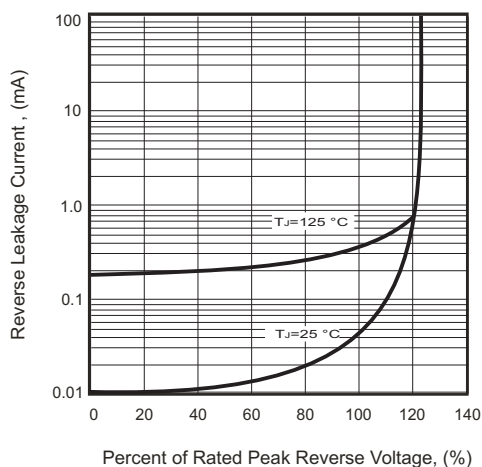


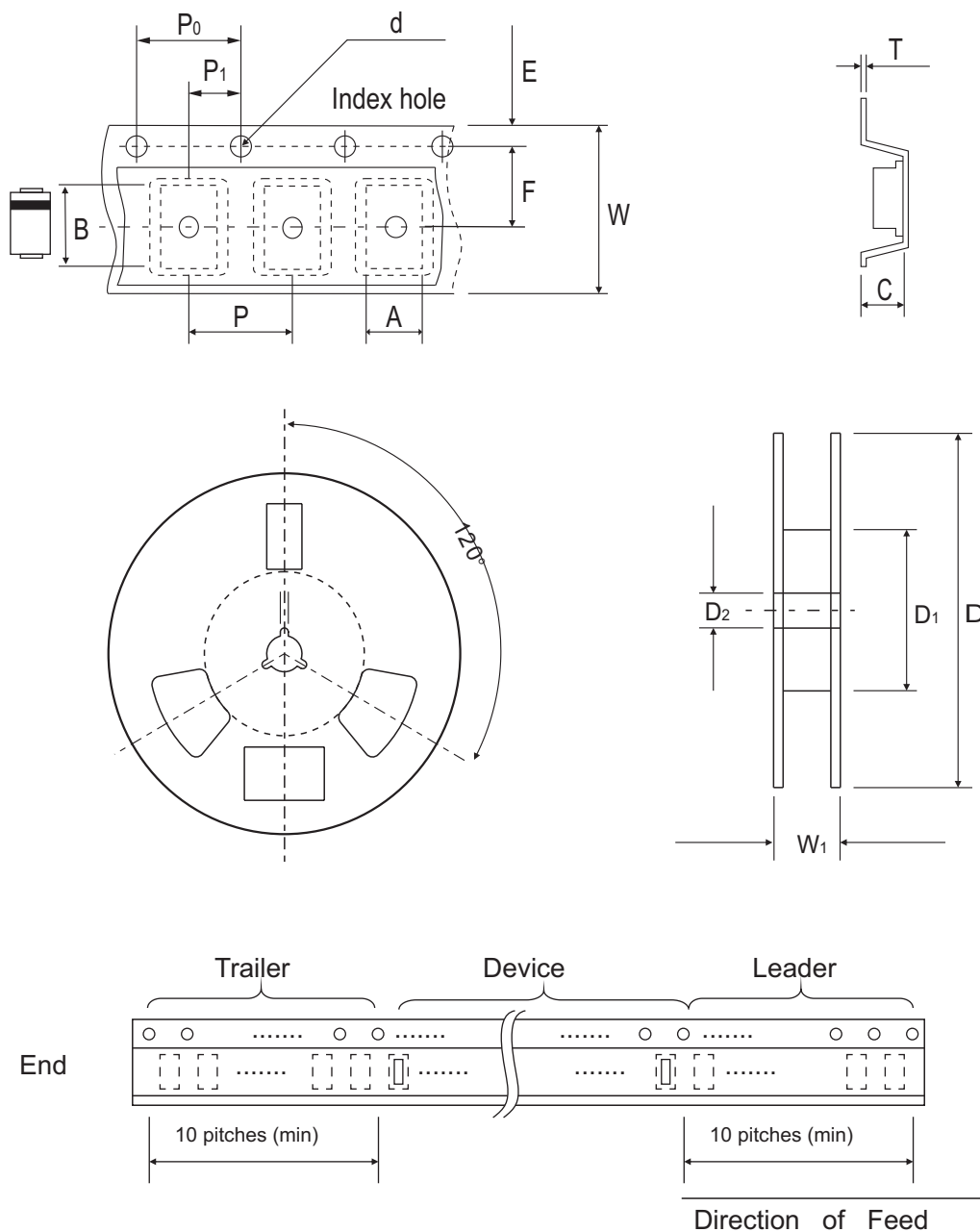
Fig.5 - Typical Reverse Characteristics



Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:B

Reel Taping Specification



DO-214AC (SMA)	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	2.70 ± 0.10	5.30 ± 0.10	2.66 ± 0.10	1.50 ± 0.10	330 ± 2.00	62.0 MIN.	13.50 ± 0.50
	(inch)	0.106 ± 0.004	0.209 ± 0.004	0.105 ± 0.004	0.059 ± 0.004	12.99 ± 0.079	2.441 MIN.	0.531 ± 0.020

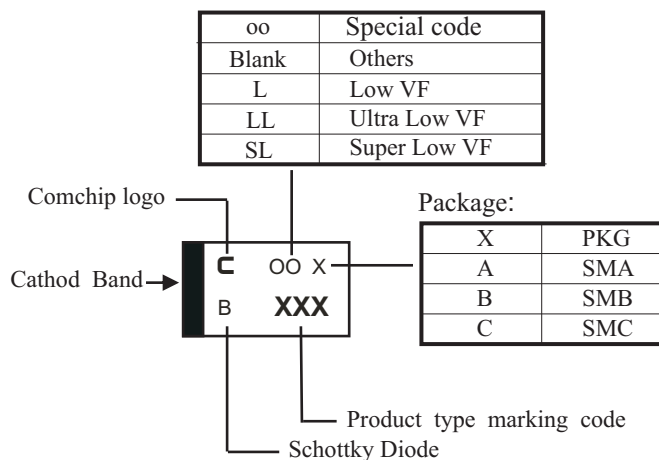
DO-214AC (SMA)	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	T	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	5.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.60 ± 0.10	12.0 ± 0.30	18.40 ± 1.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.217 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.236 ± 0.004	0.472 ± 0.012	0.724 ± 0.039

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:B

Marking Code

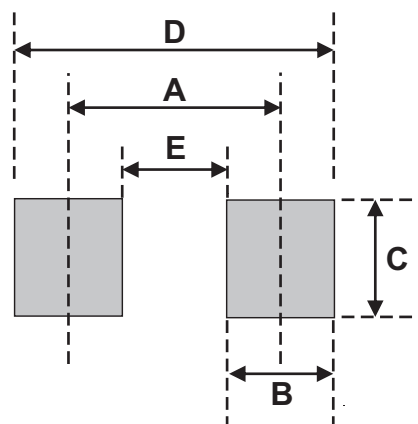
Part Number	Marking Code
CDBA140-HF	140
CDBA160-HF	160
CDBA1100-HF	1100



xxx/xxxx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	DO-214AC (SMA)	
	(mm)	(inch)
A	4.00	0.157
B	2.50	0.098
C	1.70	0.068
D	6.50	0.256
E	1.50	0.060



Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
DO-214AC (SMA)	5,000	13

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9